

ISO-Cream® No-clean SMD-Lotpasten

Homogene, gebrauchsfertige und geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs-, Fluss- und Thixotropiermitteln. Dosen à 250 g und 500 g, Dispenserkartuschen 5, 10, 30 ccm

“Active-Clear“

Hervorragende Benetzung auf allen Leiterplattenoberflächen insbesondere NiAu und NiPd unter Normal-, Schutzgasatmosphäre sowie auch in der Dampfphase, basierend auf synthetischen Harzen (kolophoniumfrei), klare unauffällige Rückstände, minimale Voidbildung, Halogenidgehalt < 0,15% (REL1)

“Clear“

Halogenidfreie Variante unserer ISO-Cream® “Active-Clear“, basierend auf synthetischen Harzen (kolophoniumfrei), klare unauffällige Rückstände, minimale Voidbildung, Verarbeitungszeitraum mindestens 72 Std., halogenidfrei (<0,01%), RELO

“Clear“



Halogenidfreie Variante unserer ISO-Cream® “Active-Clear“, basierend auf synthetischen Harzen (kolophoniumfrei), klare unauffällige Rückstände, minimale Voidbildung, Verarbeitungszeitraum mindestens 72 Std., halogenidfrei (<0,01%), RELO



Signifikante Reduzierung des CO2-Footprint

Mit **GreenTin** haben wir uns für ein nachhaltiges und hochreines Zinn der Feinhütte entschieden, das vollständig aus Recyclingmaterialien gewonnen wird. Durch präzise Upcycling-Prozesse erreicht die Feinhütte dabei Reinheitsgrade von bis zu 99,99 %. Das Ergebnis ist ein ökologisch gewonnenes Material höchster Güte. Statt auf Rohstoffe aus Minen, setzen wir auf eine besonders umweltfreundliche, europäische Alternative.

Legierung	CO ₂ -Emission (pro kg)			
	Primärmetall*	Anteilig	Recyclingmetall	Anteilig
Sn96,5Ag3Cu0,5				
96,5 % Zinn	10,15 kg	9,795 kg	0,93 kg	0,897 kg
3,0 % Silber	449,39 kg	13,48 kg	52,0 kg	1,560 kg
0,5 % Kupfer	4,87 kg	0,024 kg	0,8 kg	0,004 kg
CO ₂ - Footprint		23,305 kg		2,461 kg
CO₂-Reduzierung um 20,844 kg = 89,44 %! im Vergleich des Lotpulveranteils einer SMD-Lotpaste aus Primärmetallen				

Bleifreie Legierungen

Schmelzbereich

Sn96,5Ag3Cu0,5	217 - 219 °C
Sn100Ni+® / SN100-403C® Sn99,25Cu0,7Ni0,05	227 °C eutektisch
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	217 °C eutektisch
Sn96,5Ag3,5	221 °C eutektisch
Sn77,2In20Ag2,8	175 - 187 °C

Bleihaltige Legierungen

Schmelzbereich


Sn62Pb36Ag2	179 °C eutektisch
Pb93Sn5Ag2	296 - 301 °C

Weitere Legierungen auf Anfrage.

Korngrößen

Typ 2	Standard	45 - 75 µm
Typ 3	Fine-Pitch	25 - 45 µm
Typ 4	Fine-Pitch	20 - 38 µm
Typ 5	Ultra-Fine-Pitch	15 - 25 µm
Typen 6-8 Auf Anfrage		

* Effizienz-Agentur NRW

Eigenschaft	ISO-Cream Clear	ISO-Cream Clear  GreenTin®	ISO-Cream Active-Clear	ISO-Cream EL 42/58	ISO-Cream EWL 2303	ISO-Cream RA 2601
EN ISO 9454-1 / 61190-1-1	1231 / RELO	1231 / RELO	1222 / REL1	1122 / ROL1	2131 / ORMO	1123 / ROM1
No Clean	•	•	•	•		
Rückstände leicht entfernbar	•	•	•	•	•	•
Schablonendruck	•	•	•	•	•	•
Dispenser	•	•	•	•	•	
Jetprint	•	•	•		•	
Stempeldruck / Pin in Paste	•	•	•		•	
Dampfphase	•	•	•			
Klebrigkeit > 48 Std.	•	•	•			
Bleifrei	•	•	•	•	•	•
Bleihaltig					•	•
Hoch bleihaltig (Pb > 85 %)	•	•	•			•

SMD-Spezialweichlötpaste

Homogene, gebrauchsfertige und geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs-, Fluss- und Thixotropiermitteln.

ISO-Cream® "RA 2601" Flussmittel nach DIN EN ISO 9454-1, 1123 bzw. DIN EN 61190-1-1, ROM1. Speziell für schlecht benetzbare Lötpartner. Die Flussmittelrückstände auf den gelöteten Schaltkreisen sollten entfernt werden.

ISO-Cream® "EL 42/58" No-Clean SMD-Lötpaste für temperaturempfindliche Bauteile
ISO-Cream® "EL 42/57/1" wie z.B. LEDs, niedrige Peaktemperatur (ca. 170 °C) im Lötprozess, lötbar unter Normal- und Schutzgasatmosphäre, hohe Konturenstabilität, Halogenidgehalt < 0,15 % (ROL1)
 Legierung: Bi58Sn42 - 138 °C eutektisch
 Legierung: Bi57Sn42Ag1 - 138 -139 °C

ISO-Cream® "EWL 2303" Wasserlösliche Lotpaste für eine exzellente Benetzung auf allen bekannten Flächen. Flussmittel, ISO 9454-1:2016, 2131, DIN EN 61190-1-3/ IPC J-STD-004B, ORMO



Beschreibung	Inhalt
Dosen	0,250 und 0,500 kg
Kartuschen	6 und 12 oz
Dispenserkartuschen	5, 10 und 30 ccm
Andere Gebinde auf Wunsch lieferbar.	